

证券代码：688120

证券简称：华海清科

公告编号：2024-026

# 华海清科股份有限公司

## 2023 年度利润分配

### 及资本公积金转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示

●分配及转增比例：每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.90 股，不送红股。

●本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配和转增总额不变，相应调整每股分配红利和转增比例，并将另行公告具体调整情况。

●2023 年度现金分红比例低于 30%，是基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式的综合考虑。

●本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

#### 一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 723,746,551.15 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 1,320,574,036.04 元。经董事会决议，公司

2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，每 10 股派发现金红利 5.50 元(含税)，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.90 股。

以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 158,933,383 股测算，共计拟派发现金红利 87,413,360.65 元(含税)，占 2023 年度合并报表中归属上市公司股东的净利润比例为 12.08%；共计转增 77,877,358 股，转增后公司总股本增加至 236,810,741 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。

如在本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配和转增总额不变，相应调整每股分配红利和转增比例。

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交股东大会审议。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

### （一）公司所处行业情况及特点

公司主要从事半导体专用设备的研发、生产、销售及技术服务，属于专用设备制造业下的半导体器件专用设备制造。2023 年，受国际形势和宏观经济环境等因素的影响，公司所处半导体行业面临挑战，同时随着晶体管的尺寸不断缩小，摩尔定律的延续面临着器件接近物理极限，迭代速度放缓，通过内部互联技术实现多个模块芯片与底层基础芯片封装的 Chiplet 和基于 2.5D/3D 封装技术将 DRAM Die 垂直堆叠的高带宽存储器（HBM）等先进封装技术和工艺成为未来发展的重要方向。公司一方面需要持续推动 CMP、减薄等产品的技术和性能升级，推出满足更多材质工艺和更先进制程要求的新功能、新模块和新产品，持续推进面向更高性能、更先进节点的设备开发及工艺突破；另一方面需要紧跟技术发展趋势，持续加大自主研发力度，增加对芯片堆叠技术、先进封装技术等所需 CMP 和减薄设备的研发投入力度，把握市场机遇，在新领域实现突破。

### （二）公司发展阶段和自身经营模式

公司是一家拥有核心自主知识产权的高端半导体设备供应商，主要产品包括 CMP 设备、减薄设备、划切设备、供液系统、晶圆再生、关键耗材与维保服务等，

公司凭借自身的技术与产品实力在国内 CMP 设备领域的市占率稳步提升,已基本覆盖国内 12 英寸先进集成电路大生产线,处于国内领先地位。公司始终坚持以技术创新为企业发展的驱动力,并努力践行“装备+服务”的平台化发展战略,深耕集成电路制造上游产业链关键领域,大力发掘减薄设备、划切设备、湿法设备、测量设备、晶圆再生、耗材服务及其他集成电路相关领域的新机会,持续优化企业管理体系及客户服务保障能力,努力提高产品市场表现及竞争能力。目前公司仍处于快速发展阶段,需投入大量资金用于新产品研发以及产能扩张,以进一步提升公司的经营规模和产品竞争力。

### （三）公司盈利水平及资金需求

报告期内公司实现营业收入 250,799.11 万元,同比增长 52.11%;实现归属于上市公司股东的净利润 72,374.66 万元,同比增长 44.29%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 60,812.11 万元,同比增长达 60.05%。公司着眼于长远可持续发展,将继续保持高水平研发投入,持续深耕半导体关键设备与技术服务,持续推进新产品新工艺开发,提升市场竞争力。

### （四）公司现金分红水平较低的原因

鉴于公司正处于快速发展的重要阶段,公司需持续投入运营资金,以满足未来扩大研发、产能建设以及市场开拓等资金需求。公司 2023 年利润分配预案是在保证公司正常资金需求的前提下,基于公司当前的财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要而做出的,留存利润是为了满足公司未来持续发展需要,将更有利于公司价值提升,更好地维护全体股东的长远利益。

### （五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将转入下一年度,主要用于产能扩张、研发投入、生产经营和以后年度利润分配等方面。公司留存未分配利润相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素的影响。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求,并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素,积极履行公司的利润分配政策,与投资者共享公司发展的成果,更好地维护全体股东的长远利益。

## 三、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司〈2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》，同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### （二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司的实际情况和未来发展的资金需求，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

#### （三）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司〈2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司的实际情况和未来发展的资金需求，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

### 四、相关风险提示

（一）本次现金分红方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告

华海清科股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 27 日